

# IC Taiwan Grand Challenge 獲獎名單

## 1. 團隊名稱：Aniah

|      |  |
|------|--|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips   |
| 產品名稱 | Aniah OneCheck / Amigo AI  |
| 國別   | France   |
| 網址   | <a href="http://www.aniah.fr">http://www.aniah.fr</a>  |
| 簡介   | Aniah 是一家專注於先進類比與混合訊號 SoC 晶片中電晶體層級驗證的 EDA 公司。其產品 OneCheck 可在所有電源狀態與電壓域中，進行全面且無需測試向量 (vector-less) 的電氣規則檢查，能找出模擬容易遺漏的關鍵邊界情境 (corner cases)。該技術已在量產環境中驗證，支援至 1.6nm 製程節點。建立於 OneCheck 之上的 Amigo AI，則可進一步解釋問題、提供修正建議，並加速設計審查流程，協助實現首次流片成功。 |

## 2. 團隊名稱：Caesarea Labs

|      |   |
|------|---|
| 競賽領域 | Smart Manufacturing   |
| 產品名稱 | Aqueduct  |
| 國別   | Israel  |
| 網址   | <a href="https://www.caesarealabs.com/">https://www.caesarealabs.com/</a>   |
| 簡介   | Caesarea Labs 由前 Intel 工程師創立，致力於將現代化的 EDA 技術導入這個長期被忽視卻至關重要的階段，並從電路編輯，亦即晶片快速原型驗證 (rapid prototyping) 與路徑探索 (path-finding) 切入，目標是將電路編輯從一個脆弱、緩慢的工作流程，轉變為可靠、可重複且高效率的產業標準。 |

## 3. 團隊名稱：Infiniflux Ltd.

|      |  |
|------|--|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips                               |
| 產品名稱 | ChipCool   |
| 國別   | United Kingdom   |
| 網址   | <a href="http://www.infiniflux.cool">www.infiniflux.cool</a> |

|    |  |
|----|--|
| 簡介 | Infiniflux 是一家深科技新創公司，致力於重新定義資料中心的效率。其申請專利中的雙相（2-phase）Direct-to-Die 液冷系統，具備業界領先的散熱效能，即使在單顆晶片功耗超過 1000W 的情況下，仍可讓 GPU 溫度降低 15 - 20°C。其成果是可提升最多 15% 的運算能力，大幅降低能源消耗與維護成本，並使晶片壽命相較於最佳的單相（1-phase）冷卻系統至少延長 2 倍。 |
|----|--|

#### 4. 團隊名稱：Leafy Lab Inc.

|      |  |
|------|--|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips   |
| 產品名稱 | Agentic Design Platform, Predictive Device AI  |
| 國別   | United States  |
| 網址   | leafylab.io  |
| 簡介   | Leafy Lab 是一個應用型 AI 平台，致力於改變類比與混合訊號晶片設計流程。透過結合矽晶物理與 Physical AI，其可解釋性的模型，將原本需要數月反覆試錯的設計流程，縮短為僅需數天即可完成的高精度工作流程。其生成式 AI 助理能以約 2% 的誤差率預測元件行為，並自動化複雜版圖設計。Leafy Lab 協助晶片設計師優化效能，目標是將產品上市時間縮短 50%，並實現首次流片成功。 |

#### 5. 團隊名稱：Linque

|      |  |
|------|--|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips   |
| 產品名稱 | Linque RISE  |
| 國別   | Germany  |
| 網址   | <a href="https://linque.eu">https://linque.eu</a>  |
| 簡介   | Linque 透過大規模光子積體電路，實現超高速、節能的全光交換。其可擴展至 CMOS 製程的技術，能有效降低網路功耗、空間占用與延遲，進一步推動下一代 AI 資料中心的發展。 |

#### 6. 團隊名稱：Oculi

|      |   |
|------|---|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips  |
| 產品名稱 | OCULI Sensor & Processing Unit (SPU) for fastest & lowest power AI Vision |
| 國別   | United States   |

|    |  |
|----|--|
| 網址 | <a href="http://www.oculi.ai">http://www.oculi.ai</a>  |
| 簡介 | Oculi 正在重新定義邊緣端 Vision AI，透過最大化效率、保護隱私，並實現即時智慧，讓 AI 視覺運算更加高效。其核心技術 IntelliPixel® 將每一個像素轉化為智慧且可程式化的感測單元，只處理真正必要的關鍵資料，大幅降低功耗、頻寬需求與系統成本，同時提供超低延遲的全天候 AI 效能。 |

#### 7. 團隊名稱：ROCKCORE TECHNOLOGY CO., LTD.

|      |  |
|------|--|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips   |
| 產品名稱 | Core-Align Ultra: AMD+FPGA - Accelerated Adaptive Vision Engine  |
| 國別   | Taiwan   |
| 網址   | <a href="https://www.rockcoretek.com/">https://www.rockcoretek.com/</a>  |
| 簡介   | RockCore Technology 開發基於 AMD 與 FPGA 的異質運算系統 (AI-FPC)，應用於國防與高階設備領域。公司初期專注於 IC 載板，並計畫逐步擴展至半導體產業，主要專案包含國防追蹤系統以及 Adtec 曝光對位系統。RockCore 亦與工業技術研究院及研華科技合作，提供核心硬體設計、FPGA 整合，以及市場拓展服務。 |

#### 8. 團隊名稱：STR8 Industries

|      |   |
|------|---|
| 競賽領域 | Smart Mobility  |
| 產品名稱 | STR8 Maritime Autonomy Platform   |
| 國別   | United States   |
| 網址   | N/A   |
| 簡介   | STR8 Industries 是一家由創投支持的美國 - 台灣合資海事自主技術公司 (maritime autonomy company)，專注於開發自主導航軟體與整合式船載系統。其種子輪融資由一位在無人系統領域具指標性的先驅人物領投。STR8 的工程研發與快速實海測試主要設在台灣，以加速產品迭代並推動規模化部署。 |

#### 9. 團隊名稱：ThermoVerse Inc.

|      |  |
|------|--|
| 競賽領域 | Sustainability                             |
| 產品名稱 | LATCHES: The Battery Hidden in Plain Sight |
| 國別   | United States                              |

|    |   |
|----|---|
| 網址 | <a href="https://www.thermoverse.com/">https://www.thermoverse.com/</a>   |
| 簡介 | ThermoVerse 核心產品為 LATCHES，智慧建築中的「熱能肌肉 (thermal muscle)」系統。該系統採 zero-footprint 的相變材料 (PCM, phase-change material) 充電電池技術，可使 HVAC 能源消耗降低 20% 至 60%。ThermoVerse 目前正尋求台灣的策略合作夥伴，共同開發「矽腦 (silicon brain)」，一款客製化的超低功耗 IC，以支持其產品從天花板磁磚進化為智慧壁紙，並將高精度環境溫控技術推向全球市場。 |

#### 10. 團隊名稱：TopoLogic Inc.

|      |  |
|------|--|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips   |
| 產品名稱 | TL-RAM   |
| 國別   | Japan  |
| 網址   | <a href="https://www.topologic.jp/en">https://www.topologic.jp/en</a>  |
| 簡介   | Topologic 開發 TL-RAM，該技術利用非共線拓撲反鐵磁記憶體 (non-collinear topological antiferromagnetic memory)，打造具備磁性記憶能力的儲存方案，可達到亞奈秒級 (sub-nanosecond) 的運作速度與 GB 等級容量。此技術可使高效能邏輯晶片處理器中的最後一級快取容量提升約 10 倍，進而顯著增強 GPU、CPU 與 TPU 的整體運算能力。透過允許更大規模的程式在晶片內直接處理，TL-RAM 減少對晶片外部記憶體存取所造成的延遲，從而大幅提升整體計算效率。 |

#### 11. 團隊名稱：Vellex Computing, Inc.

|      |   |
|------|---|
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips  |
| 產品名稱 | Vellex Platform   |
| 國別   | United States   |
| 網址   | <a href="https://www.vellex.ai">https://www.vellex.ai</a>   |
| 簡介   | Vellex 正在引領一場 AI 架構轉型，透過高速度、超低功耗的邊緣運算裝置，推動高效能 AI 的普及化。其架構可在僅需 1% 能耗 (相較 GPU) 的情況下，達到 GPU 等級的運算效能，使得在穿戴式裝置與感測器等電池供電設備上，也能於本地端進行即時 AI 訓練，例如喚醒詞偵測或異常偵測，無需依賴雲端運算。 |